



## 打破陈规：全新SCHOTT® TEC TO封装

### 10Gbit/s带制冷器件的理想封装选择

*中国深圳和德国兰茨胡特，2015年8月31日* -德国高科技跨国公司肖特拓展了其面向

10Gbit/s应用的高性能TO封装设计组合，用于满足高频、带制冷有源器件应用的需求。全

新的SCHOTT® TEC TO封装可助力电信及数据通信领域开发出数据传输速率极高的应用，

是需要热电制冷器（TEC）的10Gbit/s激光器的理想选择，可实现中长距离传输。基于TO

结构的封装, 其尺寸也小于常规壳体式封装。2015年8月31日至9月3日，肖特将在深圳举办

的中国国际光电博览会上展示其最新的TEC TO（1号馆，1B60号展位）。

在为高频应用设计TO封装时，阻抗匹配和空间限制是开发人员面临的最大挑战。肖特借助

全新的TEC TO设计克服了这些局限性。该热电制冷器可控制散热，从而确保稳定的激

光波长。这个全新设计基于一个加长的射频馈通，能大大缩短打线长度，减少激光

器的信号损失，从而提高了整体性能。

此外，全新的TEC TO是一个基于导电良好的钢制基板的TO封装设计，不再依赖于盒式管

壳设计。肖特电子封装中国区销售总监Derek Ye对此解释道：“盒式管壳封装在缩减尺寸方

面有着天然的局限性。TO封装是业内最为熟知的封装形式，玻璃封接的小型化极限已被打

破，在克服了一系列挑战后，我们可以借助一个TO封装来满足客户的所有需求，为客户提

供了一个可替代常规盒式管壳封装的经济型选择方案。”



肖特® TEC TO专为那些采用带制冷器件实现10Gbit/s数据传输速率的电信和数据通信应用而设计。该产品新近上市，可供客户进行评估。它适合各种TEC尺寸，并提供可进一步提升散热效果的可选方案。

Derek Ye表示：“凭借长达50年丰富的TO研发和实践应用专业知识，肖特将继续引领行业创新。最新推出的TEC TO以更小的尺寸实现了无与伦比的性能，将助力电信和数据通信领域释放更多潜能。”

除了标准产品系列，肖特还提供定制化的TEC TO解决方案。Derek Ye补充道：“对于我们而言，TEC TO管座不仅仅是一款产品，它还突显了我们在高频应用领域的研发能力。”新型TEC TO封装展示了肖特在设计和制造面向创新型高速电信及数据通信应用的密封封装产品的领先地位。

## 背景信息

密封封装管壳对于高速电信及数据通信应用为何如此重要？电子芯片对于湿度的热波动非常敏感。如果湿度较高，水汽凝结就有可能发生，尤其是在温度较低时。这可能导致半导体金属部件腐蚀。随着带宽需求不断提高，这些芯片对有害气体和环境可能更敏感，也更易受其影响。即使有微量的氢和水汽侵入也会损坏光电组件的功能。此外，湿度还能导致半导体元件退化，从而导致整个设备失效。因此，高性能芯片需要高性能的封装产品。



更多信息，敬请访问：[www.schott.com/epackaging](http://www.schott.com/epackaging)。

图像下载链接：



SCHOTT® TEC TO 专为那些采用带制冷器件实现 10Gbit/s 数据传输速率的电信和数据通信应用而设计。来源：肖特。

肖特是专业玻璃和玻璃陶瓷领域业界领先的跨国技术集团。该公司拥有超过 130 年卓越的开发、材料和技术专长，提供广泛的优质产品和智能解决方案组合。肖特是许多行业创新的推动者，包括家电、医药、电子、光学、汽车和航空工业。肖特致力于持续创新和成功，在人们的生活中努力扮演着重要的角色。集团在全球 35 个国家设有生产基地和销售办事处，拥有约 15,400 名员工，在 2013/2014 财年取得 18.7 亿欧元的销售额。其母公司，SCHOTT AG，总部位于美因茨（德国），由卡尔蔡司基金会独资拥有。作为一家基金公司，肖特对其员工、社会和环境承担着特殊的责任。[www.schott.com](http://www.schott.com)



**Press contact:**

SCHOTT AG

Dr. Haike Frank

Public Relations Manager

Hattenbergstr. 10, 55122 Mainz, Germany

Telefon: +49 (0)6131/66-4088

E-Mail [haike.frank@schott.com](mailto:haike.frank@schott.com)

Internet: [www.schott.com](http://www.schott.com)